

セミアディティブ工法対応パラジウム残渣除去プロセス

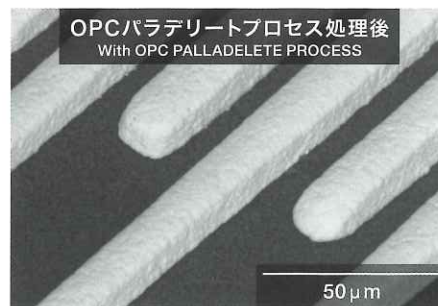
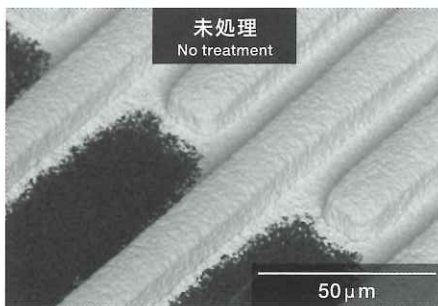
Palladium Residue Removing Process Applicable for Semi-additive Process

OPCパラデリートプロセス

OPC PALLADELETE PROCESS

- シアンを使用しないプロセス
- 弱アルカリ性で、基材へのアタックが少ない
- 微細配線パターン間のパラジウム残渣除去性に優れる
- 銅溶解量が非常に低い(0.05 μm 以下)
- 分析管理が可能

- Cyanide-free process
- Using weak-alkaline solution to reduce the damage against substrates
- Strongly remove palladium residues among circuits
- Greatly reduce copper dissolution amount (below 0.05 μm)
- Analytical control is available



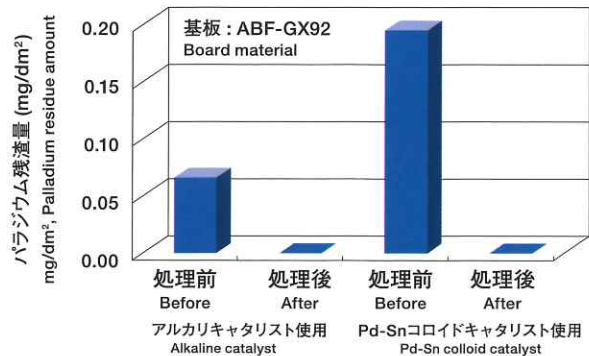
無電解ニッケルめっき: 3 μm 、置換金めっき: 0.05 μm L/S=15/15 μm
Electroless nickel plating: 3 μm , Immersion gold plating: 0.05 μm , L/S=15/15 μm

処理工程 Process

脱脂 Cleaning	OPCパラクリン OPC PALLACLEAN	pH: 酸性 45°C, 3分 pH: Acid 45°C, 3 min.
↓		
パラジウム 残渣除去 Palladium removing	OPCパラデリート 過硫酸ナトリウム OPC PALLADELETE Sodium persulfate	pH: 10 35°C, 5分 pH: 10 35°C, 5 min.
↓		
アルカリ洗浄 Alkaline cleaning	OPCパラリンス OPC PALLARINCE	pH: アルカリ 25°C, 2分 pH: Alkaline 25°C, 2 min.

パラジウム残渣除去性

Removing performance for palladium residue

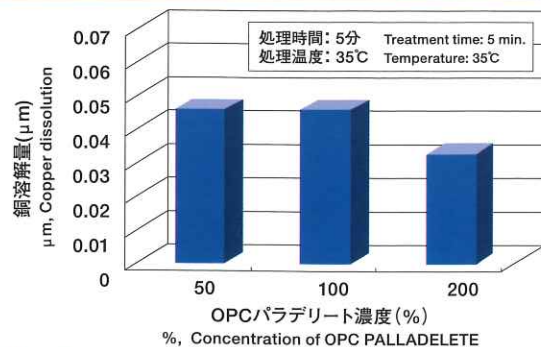
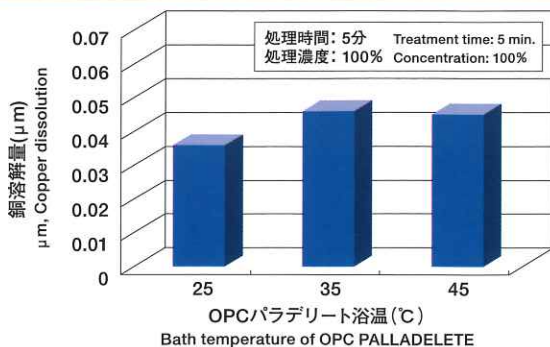


**パラジウム残渣量の多い
Pd-Snコロイドキャタリストにも対応**

Applicable to catalyst of Pd-Sn colloid to form a large amount of palladium residue

OPCパラデリート処理条件が銅溶解量に及ぼす影響

Effect of an operating condition of OPC PALLADELETE on copper dissolution amount



銅溶解量が非常に低く、微細配線パターンへの適応が可能

This is the best process for micro-fine circuit pattern, since less dissolution of copper material.